



慧荣科技推出适用于工业和汽车应用设计，搭载 i-temp 的 PCIe Gen4 BGA FerriSSD® 高性能芯片

March 27, 2024

将在 Embedded World 2024 嵌入式电子与工业应用展上展示全系列 Ferri 嵌入式存储解决方案

台北和奥兰治讯：2024 年 3 月 27 日-- 全球 NAND 闪存主控芯片领导厂商慧荣科技 (Nasdaq:GS, SIMO)，今日宣布推出新一代 FerriSSD NVMe PCIe Gen 4 x4 BGA SSD，最新解决方案支持 i-temp 并整合先进 IntelligentSeries™ 技术，即使在极端的高温环境下也能确保稳健的数据完整性，满足工业嵌入式系统和汽车应用的严格要求。



最新的 FerriSSD BGA SSD 支持 PCIe Gen 4 x4，在 16 mm x 20 mm 的晶圆 BGA 封装芯片中采用高容量 3D NAND 技术，运用慧荣科技最新创新技术的高性能嵌入式 SSD，存储容量高达 1TB，实现 6GB/s 以上的高速连续读取速度和 4GB/s 以上的连续写入速度。搭载慧荣科技独家研发的 IntelligentSeries™ 数据保护技术，通过加密、数据缓存、数据扫描和保护功能提高可靠性和性能。同时支持 -40°C 至 +85°C 精确温度下运行的 i-temp 要求。最新的 FerriSSD BGA 提供高性能和高可靠性的嵌入式存储解决方案，运用在广泛的应用和工作环境，包括汽车计算、物联网客户端计算、销售终端、多功能打印机、电信设备、工业自动化工具，以及各种服务器的应用。

FerriSSD 解决方案的其它功能包括：

- 内置 SR-I/OV 功能，使虚拟机共享一个物理 PCIe 设备，确保更大的灵活性和可扩展性，同时保持安全性。
- 搭载 eFuse 和 AES-128/256 加密的数字签名固件
- TCG Opal v2.01 认证
- 搭载真随机数生成器 (TRNG) 的硬件 SHA384，提供最强大的数据安全性

慧荣科技致力于开发创新和适应性较强的先进解决方案。我们将高兴地宣布将在 Embedded World 2024 上亮相最新的嵌入式存储技术。欢迎在 1 楼 385 号展位与我们会面，了解更多关于这一突破性技术的信息。更多资讯欢迎访问 <https://www.siliconmotion.com/events/2024EW/>。

关于慧荣

慧荣科技 (Silicon Motion Technology Corp., Nasdaq:GS, SIMO) 是全球最大的 NAND Flash 主控芯片供应商，其中 SSD 主控芯片的出货量全球第一，应用在服务器、PC 及其他消费电子产品。慧荣同时也是 MMC 和 UFS 嵌入式存储主控芯片的市场领导者，产品广泛应用于智能手机、IoT 物联网及其他存储设备。我们同时为大型数据中心、车载和工业市场提供可定制化、高性能的 SSD 解决方案。客户包括多家的 NAND Flash 大厂、存储模组模组厂及 OEM 原厂等。更多资讯请浏览 www.siliconmotion.com

媒体联系人：林莉贞(Minnie Lin)

协调：市场部
慧荣科技股份有限公司
Tel: +886-3-2219-6668 ext 3010
E-mail: pr@siliconmotion.com

高源 (Vicky Gao)

Macrom 营销公关部
慧荣科技股份有限公司
Tel: +86-021-65307780 ext 7364
E-mail: sales@siliconmotion.com

谢淑英(Shelia Hsueh)

资深关系
慧荣科技股份有限公司
Tel: +886-3-2219-6668 ext 2311
E-mail: ir@siliconmotion.com

销售联络：E-mail: service@siliconmotion.com